

2009年2月期中間決算説明資料



2008年10月21日
RORZE CORPORATION

2009年2月期 中間連結損益計算書

(百万円)

	2008年2月期 中間実績	2009年2月期 中間実績	増減率	増減理由等
売上高	7,998	5,765	△27.9%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 世界的な半導体設備投資の減少により、ウエハ搬送装置の受注が低調に推移 <p>【増加要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 韓国における液晶関係の積極的な設備投資による、ガラス基板搬送装置の受注増加
売上総利益	2,129	1,370	△35.6%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 当社、並びに台湾・米国子会社の減収と、それに伴うベトナム生産子会社の生産量低下 <p>【増加要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 韓国子会社の増収
販管費	1,094	1,030	△5.8%	<p>【減少要因】</p> <ul style="list-style-type: none"> 減収に伴う販売関連費用の減少
営業利益	1,035	339	△67.2%	
経常利益	1,065	256	△75.9%	(営業外損益の増減につきましては、中間決算短信をご参照下さい)
中間純利益	728	35	△95.1%	(特別損益の増減につきましては、中間決算短信をご参照下さい)

2009年2月期 中間連結貸借対照表

(百万円)

	2008年2月期 中間実績	2009年2月期 中間実績	増減額	増減理由等
流動資産	13,469	10,788	△2,681	・現金及び預金 +671 ・受取手形及び売掛金 △2,327 ・棚卸資産 △945
固定資産等	9,073	7,692	△1,380	・建物及び構築物 △606 ・機械装置及び運搬具 +149 ・土地 △269 ・投資その他の資産「その他」 △527
資産合計	22,543	18,481	△4,061	
流動負債	8,707	6,631	△2,076	・支払手形及び買掛金 △1,002 ・短期借入金 △449 ・その他 △449
固定負債	3,542	2,330	△1,212	・長期借入金 △1,153
負債合計	12,250	8,961	△3,289	
株主資本合計	7,855	8,284	429	・利益剰余金 +429
評価・換算差額合計	702	△233	△936	・為替換算調整勘定 △891
少数株主持分	1,734	1,468	△266	・少数株主持分(主に韓国子会社) △266
純資産合計	10,292	9,519	△772	
負債純資産合計	22,543	18,481	△4,061	

2009年2月期 中間連結キャッシュ・フロー

(百万円)

	2008年2月期 中間実績	2009年2月期 中間実績	増減額
営業活動による キャッシュ・フロー	△833	209	1,043
投資活動による キャッシュ・フロー	△270	62	332
財務活動による キャッシュ・フロー	818	△574	△1,392
現金及び現金同等物 に係る換算差額	42	△99	△142
現金及び現金同等物 の増減額	△243	△402	△159
現金及び現金同等物 の期首残高	1,553	2,086	533
現金及び現金同等物 の期末残高	1,310	1,684	374

2009年2月期 単体中間損益計算書

(百万円)

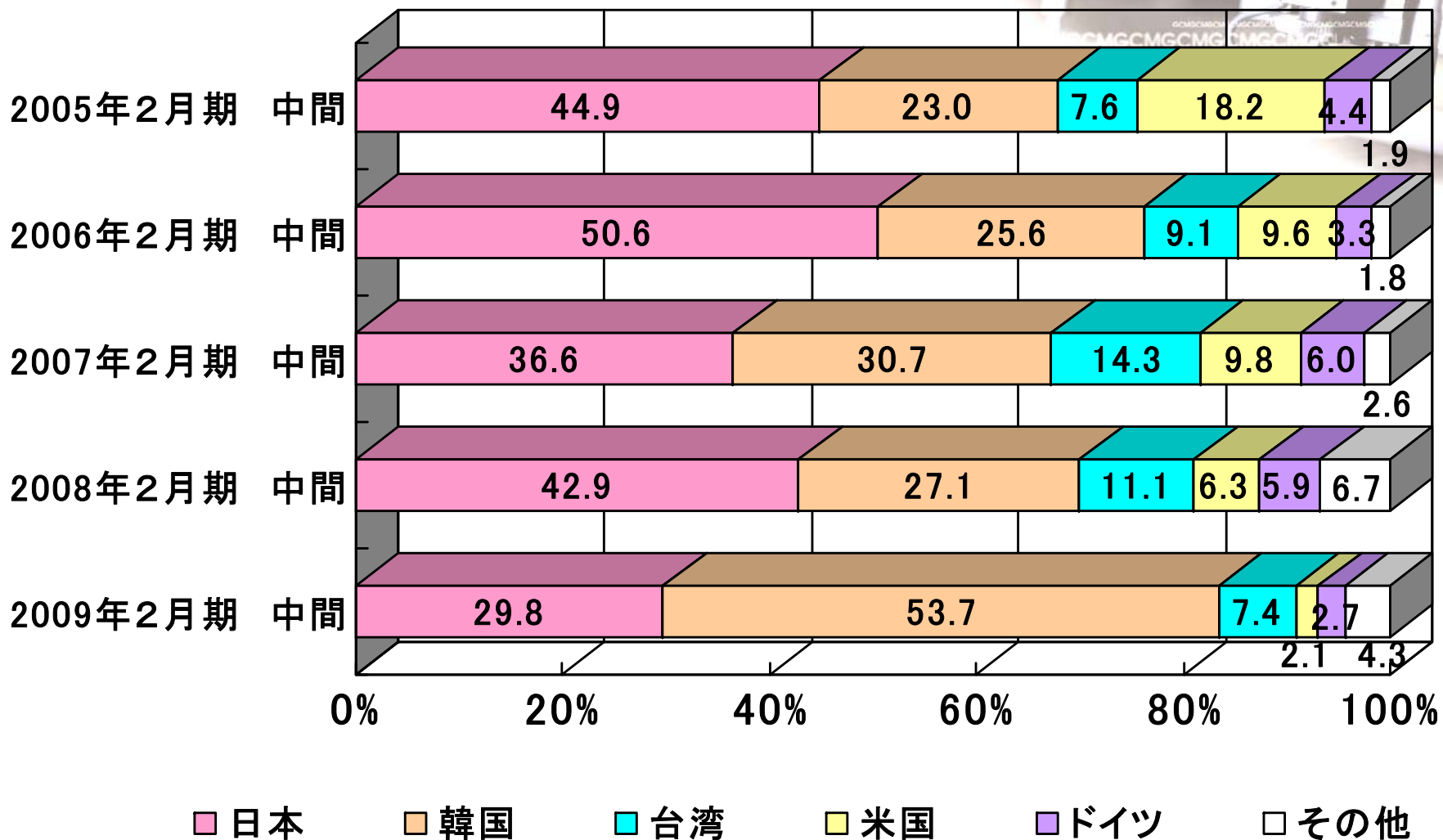
	2008年2月期 中間実績	2009年2月期 中間実績	増減率	増減理由等
売上高	5,288	2,347	△55.6%	【減少要因】 ・主に、国内の半導体設備投資計画の変更や先送りによる受注低迷
売上総利益	1,180	589	△50.1%	【減少要因】 ・売上減収
販管費	539	460	△14.7%	【減少要因】 ・減収に伴う販売関連費用の減少
営業利益	640	128	△79.9%	
経常利益	624	103	△83.3%	(営業外損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)
中間純利益	377	56	△85.0%	(特別損益の増減につきましては、 決算短信をご参照下さい)

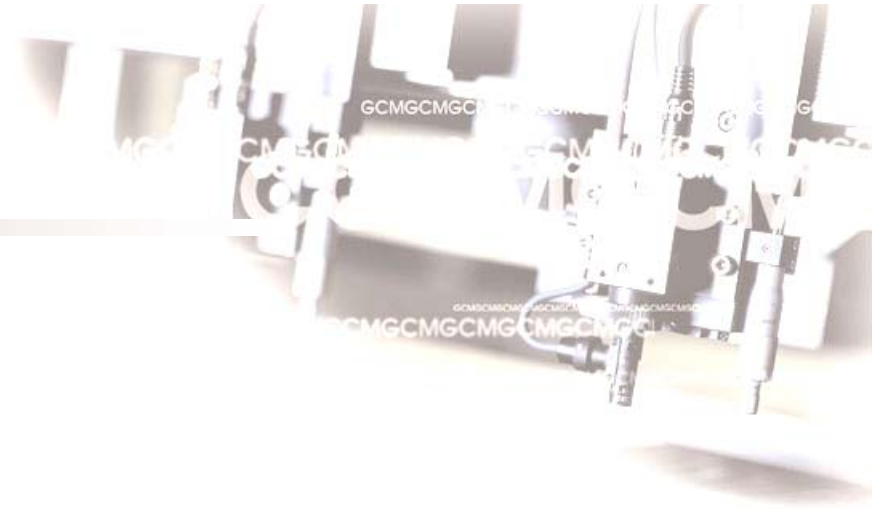
2009年2月期 単体中間貸借対照表

(百万円)

	2008年2月期 中間実績	2009年2月期 中間実績	増減額	増減理由等
流動資産	8,808	6,579	△2,228	・現金及び預金 +585 ・受取手形及び売掛金 △2,242 ・棚卸資産 △496
固定資産	7,976	7,962	△14	・減価償却費 △164 ・関係会社長期貸付金 +162
資産合計	16,784	14,542	△2,242	
流動負債	6,992	5,492	△1,500	・支払手形及び買掛金 △766 ・短期借入金 △302
固定負債	2,649	1,722	△927	・長期借入金 △916
負債合計	9,641	7,214	△2,427	
株主資本合計	6,990	7,220	229	・別途積立金 +500 ・繰越利益剰余金 △270
評価・換算差額等 合計	151	107	△44	
純資産合計	7,142	7,327	184	
負債純資産合計	16,784	14,542	△2,242	

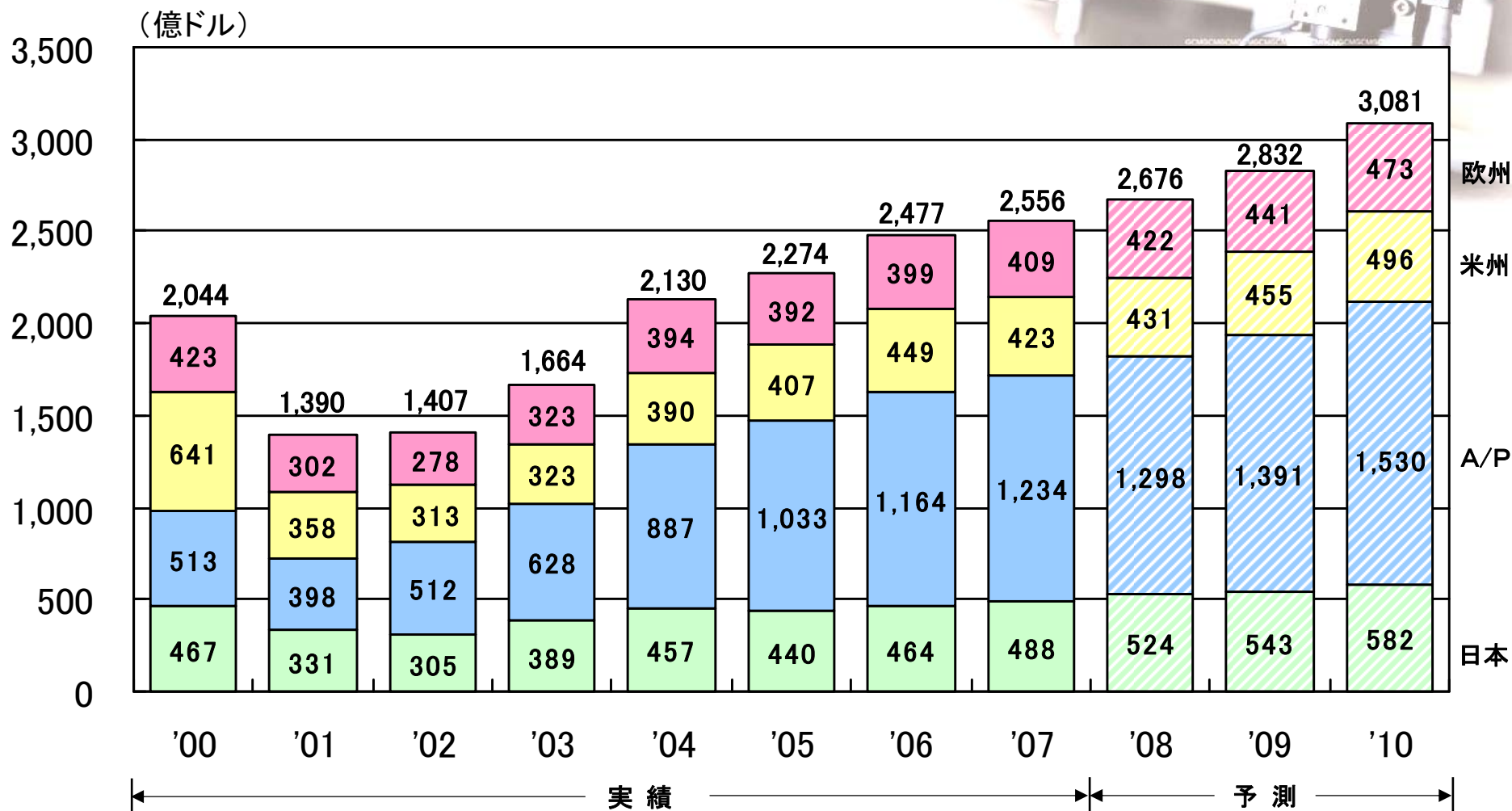
海外売上高(連結)





2009年2月期 通期業績予想

世界の地域別半導体市場規模

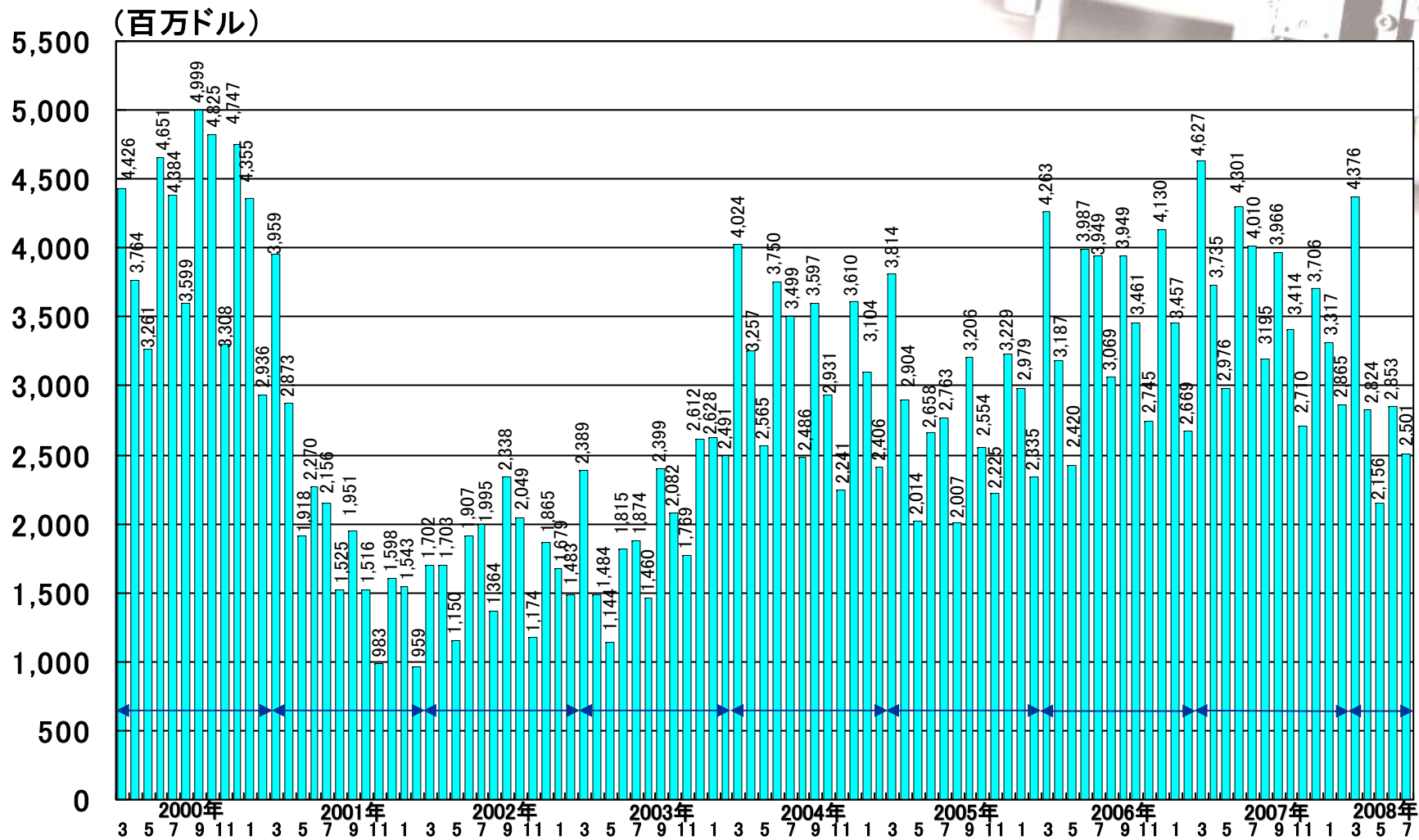


注:「A/P」はアジア・パシフィックの略

(出所:2008年5月28日付 電波新聞) (2008年5月 WSTS発表)

世界規模 半導体製造装置販売統計

(2008年7月末現在)



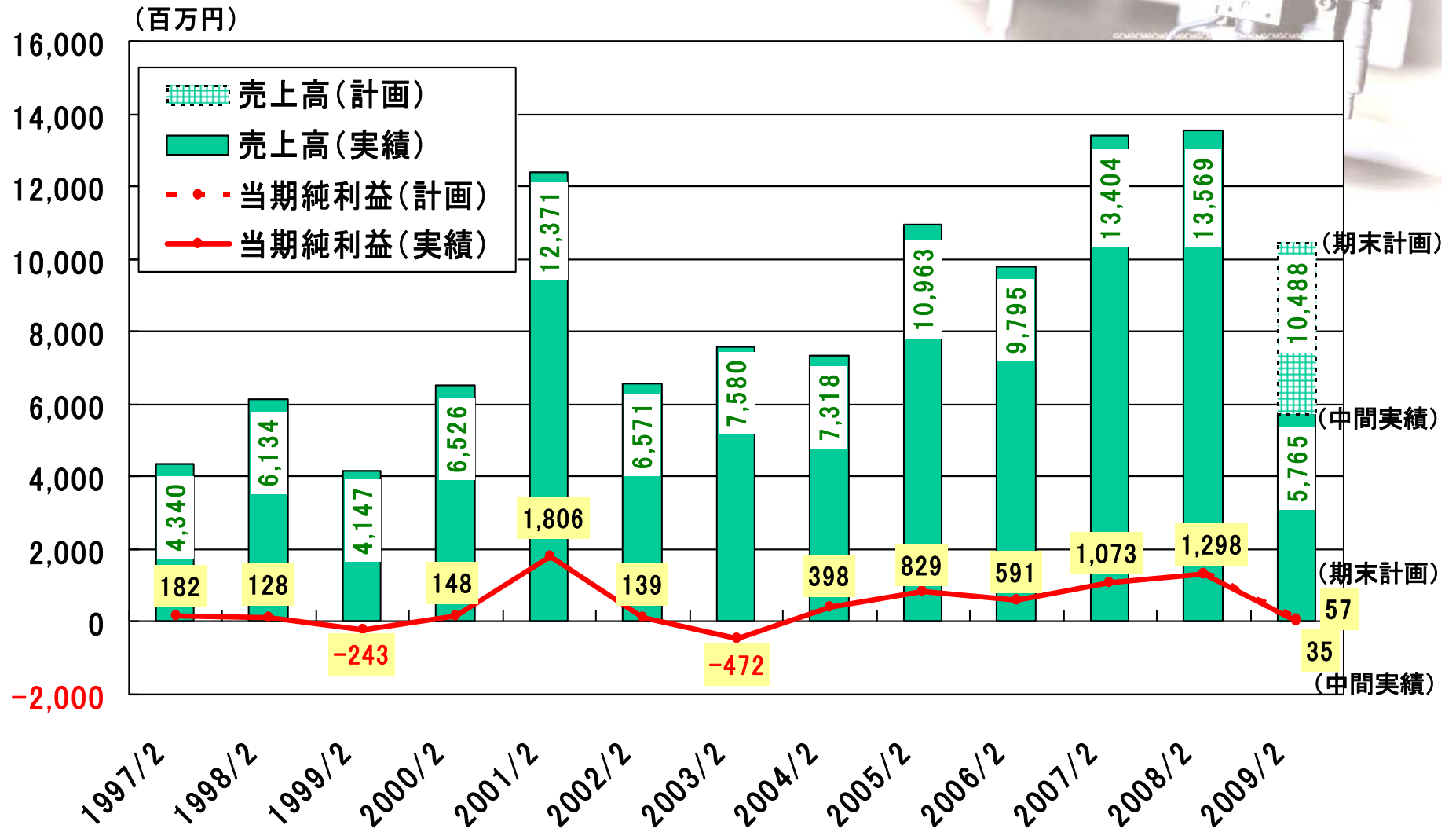
(出所：SEA J, SEMI, SEMIジャパン)

2009年2月期 連結通期業績予想

(百万円)

	2008年2月期 通期実績	2009年2月期 中間実績	2009年2月期 通期予想
売上高	13,569	5,765	10,488
売上総利益	3,987	1,370	2,503
販管費	2,157	1,030	1,996
営業利益	1,829	339	507
経常利益	1,806	256	380
当期(中間)純利益	1,298	35	57

連結業績の推移

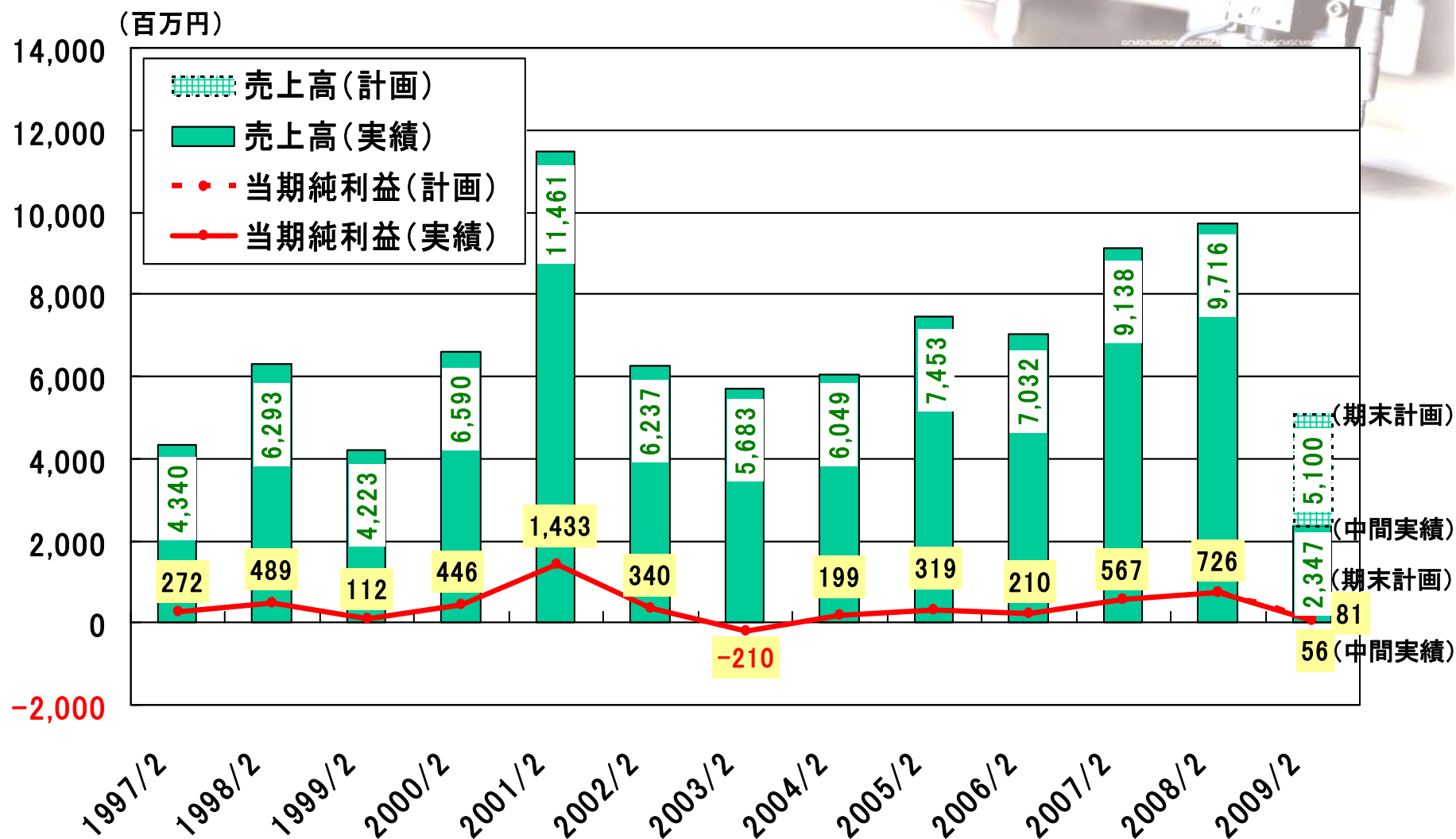


2009年2月期 単体通期業績予想

(百万円)

	2008年2月期 通期実績	2009年2月期 中間実績	2009年2月期 通期予想
売上高	9,716	2,347	5,100
売上総利益	2,353	589	1,147
販管費	1,076	460	913
営業利益	1,277	128	233
経常利益	1,243	103	161
当期(中間)純利益	726	56	81

当社(単体)業績の推移





ありがとうございました！

注意事項

この資料は、決算の業績に関する情報及び将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。

これらの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判断した見通しや予測であり、その情報の正確性、完全性を保証したり約束したりするものではありません。

また、経済動向や業界における競争、市場、諸制度等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり、今後予告なしに変更されることがあります。